

次世代に向けた半導体パッケージング技術

～最先端半導体への対応からトラブル対策まで～

<書籍版／書籍＋PDF版（CD－ROM）>

●発行 2025年11月 ●B5判ソフトカバー 259ページ

●定価 書籍版:63,800円(税込(消費税10%))・書籍版＋PDF版セット:74,800円(税込(消費税10%))

★有料付録PDF版(CD－ROM)の仕様について【必ず下記ご確認の上お申し込み下さい】

- ・PDF版のみのご購入はできません。書籍購入の方に向けた有料付録となります。
- ・書籍全文掲載・一部図表はPDF版ではカラー掲載となります。
- ・本文中のURLに関しては、印刷用に準備されたものであり、うまくリンクしない場合もございます。予めご承知おきください。
- ・本文コピー不可。印刷不可。商品ごとに、ファイルデータへ個別のパスワードを設定
- ・購入者様毎にシリアルナンバーを設定。（なお購入者以外の方が不法に利用する事は禁じます）・パスワードはCD－ROMに添付されています。

2. xD/3Dパッケージ チップレットの状況から後工程の基礎・トラブル対策、生成AIの進化への対応まで 先端半導体パッケージング技術を網羅

★生成AIの隆盛にDX化の対応など…高性能が日々求められる半導体の一番のカギ、パッケージングについて詳説！

★次世代パッケージングに向け熱い視線が送られるインターポーザーやTSV、接合技術、ガラス技術まで解説

★次世代パッケージングから見る熱設計や洗浄技術、信頼性評価などの各種動向、
基板材料や封止材、絶縁材等各種材料の最新動向もポイントをしっかり理解

抜粋目次【一部省略 詳細な確定目次はHPをご確認ください】

第1章 半導体パッケージングロードマップ
～今までの研究の歴史と現在の着地点、今後の動向～

第2章 半導体後工程パッケージング技術：基礎からトラブル対策

第3章 最先端半導体パッケージングの技術動向

第1節 2. xD/3Dパッケージの状況

第2節 チップレット

第3節 インターポーザー技術

第4節 次世代パッケージングに向けた接合技術

第5節 TSV/TGV 技術を用いた実装

第6節 ガラスサブストラート、ガラスインターポーザー、

パネルパッケージの動向

第7節 先端半導体パッケージングと熱設計

第8節 次世代パッケージング対応洗浄技術

第4章 最新パッケージング技術に向けた材料/装置と求められる性能

第1節 ガラス基板

第2節 ふっ素樹脂基板を用いたビルドアップ多層基板

第3節 半導体封止材の動向

第4節 絶縁材料

第5節 先端半導体パッケージにおけるモールドイング技術の最新動向

第5章 半導体パッケージの検査・評価技術

第1節 半導体パッケージの信頼性試験

第2節 検査技術の動向

第6章 アプリケーションから見る半導体パッケージング

第1節 AI/生成AIの隆盛と半導体パッケージング

第2節 モビリティの進化に向けた車載機器の動向と実装・パッケージ構造

☆☆詳細な目次をHPに掲載中！ぜひご確認ください☆☆

「情報機構 BC251101」と検索！ または <https://johokiko.co.jp/publishing/BC251101.php>

執筆者一覧【敬称略】○NEP Tech. S&S ニシダエレクトロニクス実装技術支援 西田秀行 ○蛭牟田技術士事務所 蛭牟田要介
○東北大学 福島誉史 ○新光電気工業株式会社 大井淳 / 荒木康 ○東京大学 丹羽正昭 ○産業技術総合研究所 渡辺直也
○よこはま高度実装技術コンソーシアム 八甫谷明彦 ○足利大学 西剛伺 ○AGC株式会社 林和孝 ○株式会社PILLAR 奥長剛
○株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 佐藤雅伸 / 鎌田公仁 ○NBリサーチ 野村和宏 ○デンカ株式会社 荒井亨
○TOWA株式会社 家治川祐一 ○エスベック株式会社 田中浩和 ○アンドールシステムサポート株式会社 谷口正純
○大阪大学 吉田浩芳 ○車載エレクトロニクス実装研究所 三宅敏広

★書籍申込書

FAX : 03-5740-8766、または、→<https://johokiko.co.jp> にて

※FAX番号はくれぐれお間違えの無い様お願い致します。

(書籍申込み要領)

★右記記入の上、FAXでお申込み、
もしくは、<https://johokiko.co.jp/>
の申込みフォームから承ります。

○お申込書を確認次第、書籍、請求書、納品書
および振込要領をお送りいたします。
(送料は弊社負担)

○未発刊の書籍をお申込みの場合、
発刊時に弊社より書籍、請求書、納品書
および振込要領をご送付いたします

○お支払いは請求日翌月末日までに、銀行振込
にてお願いいたします。原則として領収証の
発行はいたしません。

○振り込み手数料はご負担ください。

書籍名HP【BC251101】		☐ 書籍		冊数
次世代に向けた半導体パッケージング技術 書籍		☐ 書籍＋PDF		冊 ※記入の無い場合は1冊
会社名				
所属部課・役職等				
申込者氏名		TEL	FAX	
E-MAIL		上司役職・氏名		
住所〒				
備考				
ご案内をご希望の場合は今後の案内方法にレ印を記入下さい(複数回答可) ☐ e-mail ☐ FAX ☐ 郵送				

ご連絡頂いた、個人情報は弊社商品の受付・運用・商品発送・アフターサービスのため利用致します。今後のご案内希望の方には、その目的でも使用致します。
今後のサービス向上のため「個人情報の取扱に関する契約」を締結した外部委託先へ、個人情報を委託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先 policy@johokiko.co.jp